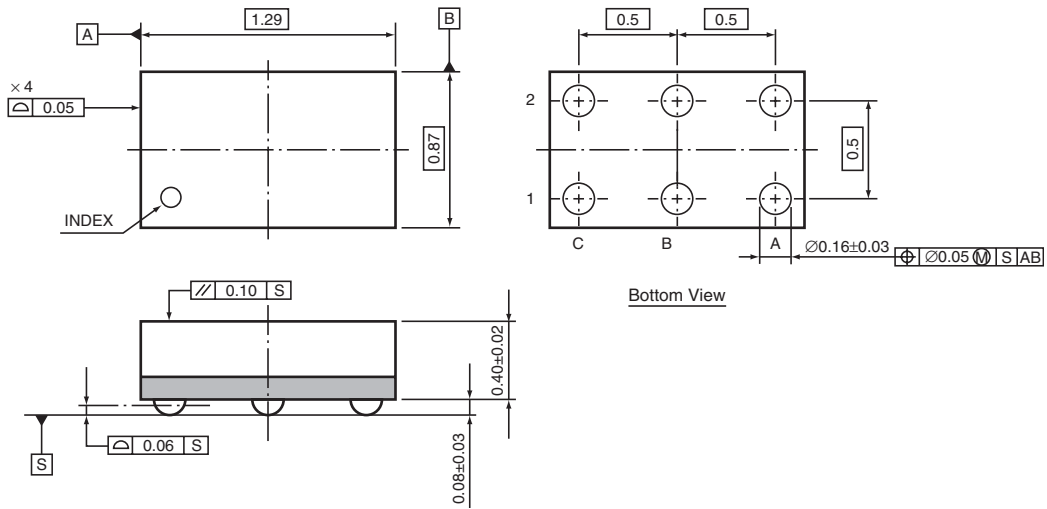


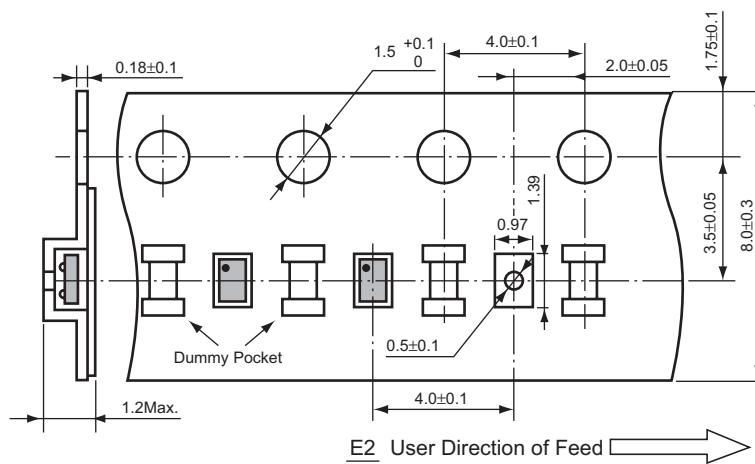
WLCSP-6-P2

(単位:mm)

パッケージ外形図

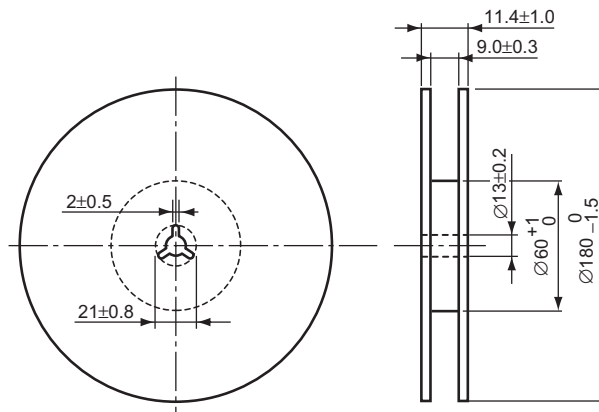


テーピング仕様



テーピングリール外形図 リユースリール (EIAJ-RRM-08Bc)

(1 リール = 5,000 個)



## 許容損失について (WLCSP-6-P2)

WLCSP-6-P2パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

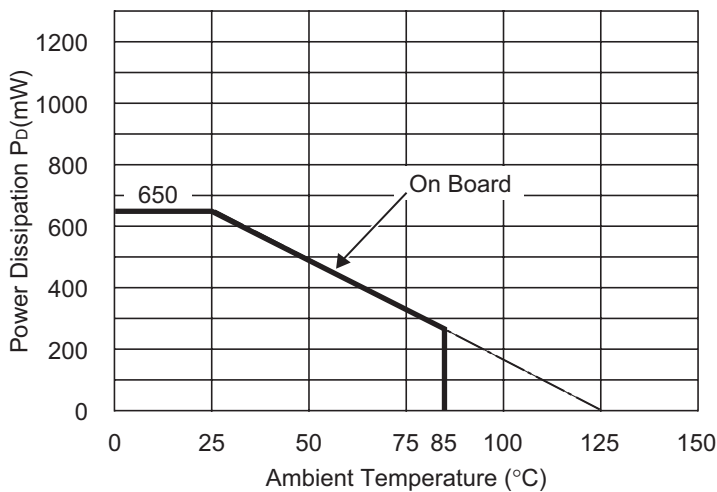
### 測定条件

標準実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約50%、裏面 約50%
スルーホール	

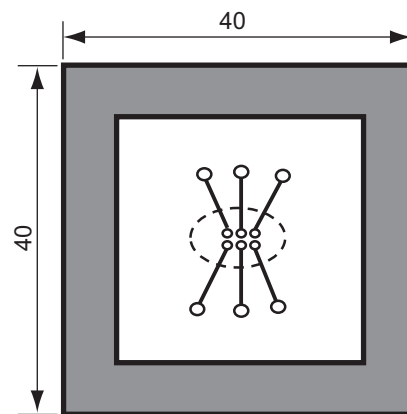
### 測定結果

(T<sub>opt</sub>=25 , T<sub>jmax</sub>=125°C)

標準実装条件	
許容損失	650mW
熱抵抗値	$ja = (125-25^\circ\text{C})/0.65\text{W} = 154^\circ\text{C/W}$



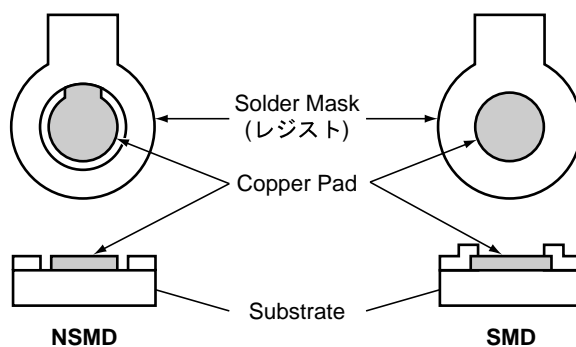
許容損失特性



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位: mm)

## 基板パッド推奨寸法 (WLCSP)



NSMD and SMD Pad Definition

Pad definition	Copper Pad	Solder Mask Opening
NSMD (Non-Solder Mask defined)	0.20mm	MIN. 0.30mm
SMD (Solder Mask defined)	MIN. 0.30mm	0.20mm

- \* ) パッド寸法の最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。
- \* ) ステンシル開口部 (推奨) ... 0.3mm
- \* ) Pbフリー製品については、共晶半田ペーストには実装しないようにして下さい。